

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华福证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等
会议时间	2026年5月19日、2026年5月20日
会议地点	线下、线上
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：韩江龙 董事会秘书：董东峰 证券事务代表：钱云 证券事务专员：张雅婷
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司如今的产品布局是怎样的？ 回复：在传统封装领域，公司产品结构全面并已实现产业化，市场份额逐步扩大，在国内市场已具备较高的品牌知名度及市场影响力；在先进封装领域，颗粒状环氧塑封料（GMC）、FC底填胶等产品已陆续通过客户考核验证，技术水平取得业内主要封装厂商的认可。公司在加大核心技术开发的同时，注重实现核心技术的产业化，公司拥有独立自主的系统化知识产权。凭借扎实的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，公司已与相关业内领先及主要企业建立稳固的合作伙伴关系，业务规模持续扩大，有序实现研发技术的产业化落地，推动经营业绩的快速提升。公司与业内主流封装厂商均已建立长期稳定的合作关系。

问题二：公司 2025 年度研发费用与 2024 年相比变动较大，请解释一下原因？

回复：研发费用变动主要系研发人员薪酬、股权激励费用、募投项目新购研发设备折旧费用增加所致。

问题三：目前，华海诚科和衡所华威整合情况如何？

回复：公司积极推进高效整合，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，以期快速取得高端封装材料技术突破。双方在市场布局、产品矩阵、供应链整合、产线布局、研发资源、服务响应、联合运输、数据共享等多方面充分发挥协同效应，提升了运营效率和抗风险能力。

问题四：公司未来的发展战略

回复：公司始终遵循“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”的企业核心价值观，坚持以市场为导向、以技术为支持、以诚实守信为根本原则，不断提高技术实力，坚持科技创新，重点关注科研成果产业化，为客户持续提供具有竞争力的半导体封装材料。

未来，公司将在巩固现有半导体封装材料竞争优势的基础上，以客户定制化需求为牵引，以先进封装技术发展趋势为导向，构建兼具前瞻性与创新性的技术研发体系，持续优化产品结构，增强企业核心竞争力。在传统封装用封装材料领域，公司依托既有优势产品加快对外资厂商产品替代，并积极围绕现有客户以及潜在客户的新增需求进行布局并开发特色产品，从而进一步扩大公司业务规模并提升市场占有率；在先进封装材料领域，华海诚科与衡所华威将加快在技术资源、客户资源的整合，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，加大对车载芯片、电容封装、存储类半导体器件用环氧塑封料的研发投入。同时优化产品结构、客户结构，快速提高在高性能和先进封装环氧塑封料应用领域的领先地位。

公司聚焦于封装材料的研发及产业化，致力于成长为中国半导体

	<p>以及相关行业封装材料的引领者与全球强有力的竞争者，持续地以打造卓越的全球化企业为目标而努力，为我国半导体及相关行业产业链发展壮大贡献力量。</p> <p>问题五：请简要介绍一下子公司衡所华威的募投项目建设情况</p> <p>回复：衡所华威积极推进现有生产线升级改造和新产线建设调试工作，保障产线设备长周期健康运行。同时对原材料预处理和材料分散提出新的工艺研究和验证，科学验证和评估耐磨设备备件和陶瓷备件，不断提升金属颗粒的管控能力。在生产工序增购了多台新设备，有效提升自动化水平。总体生产良率和产出率稳步提升，产品各项指标更加趋于稳定。</p> <p>对于与生产配套的存储设施和低温库房，做了统筹规划，改建现有库房，数字化和智能化管理水平持续提升，显著提高生产效率，同时降低人力成本，减少设备运行故障。</p> <p>问题六：公司为国产化替代做了哪些努力？</p> <p>回复：长期以来，中国半导体关键材料因为缺乏技术被“卡脖子”，因而受制于人。公司以开发全系列先进封装材料为己任，专注关键技术攻关。公司以半导体产业及半导体封装行业的发展方向为指导，围绕现有产品及技术成果，在新产品研发、配方开发、工艺优化等方面进行持续研发及技术攻关，在保持行业内技术优势地位的同时不断拓展公司产品的应用领域，为我国半导体封装材料的国产化提供了材料保障。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月19日、2026年5月20日